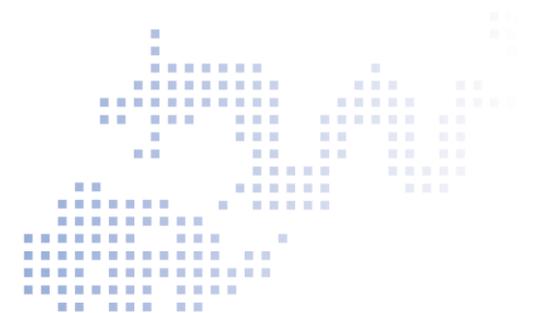


タツモ株式会社 決算説明資料

2020年12月期

2021年2月12日発表

タツモ株式会社



社名	タツモ株式会社
設立	1972年（昭和47年）2月26日
本社所在地	岡山県岡山市北区芳賀5311
資本金	27億2,406万7,238円
従業員数	単体 342名/連結 1,061名（2020年12月31日現在）



事業内容	半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、液晶製造装置、紫外線照射装置、めっき処理装置、精密金型・樹脂成型品などの開発・製造・販売
------	---

- 1972 電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立
- 1980 インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始
- 半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売を開始
- 1989 液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
- 1990 本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転
- スーパークリーンルーム用超小型搬送システムを開発、製造・販売を開始
- 1994 エンボスキャリアテープの製造・販売を開始
- 1995 インジェクション成形品の背負う・販売を開始
- 2001 半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、製造・販売を開始
- 2004 JASDAQ市場に株式を上場
- 2008 TAZMO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム：ホーチミン市）を設立

2009 第10世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始

3M社（米国）と半導体製造装置のライセンス契約を締結

2013 アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化

岡山県岡山市北区内にTAZMO VIETNAM CO.,LTD.を移転・新築

2015 第三者割当増資により、資本金16億1,683万円へ増資

2016 タツモ岡山技術センターを開設

2017 株式会社ファシリティ、株式会社クオークテクノロジーを子会社化

2018 東京証券取引所市場第一部へ市場変更

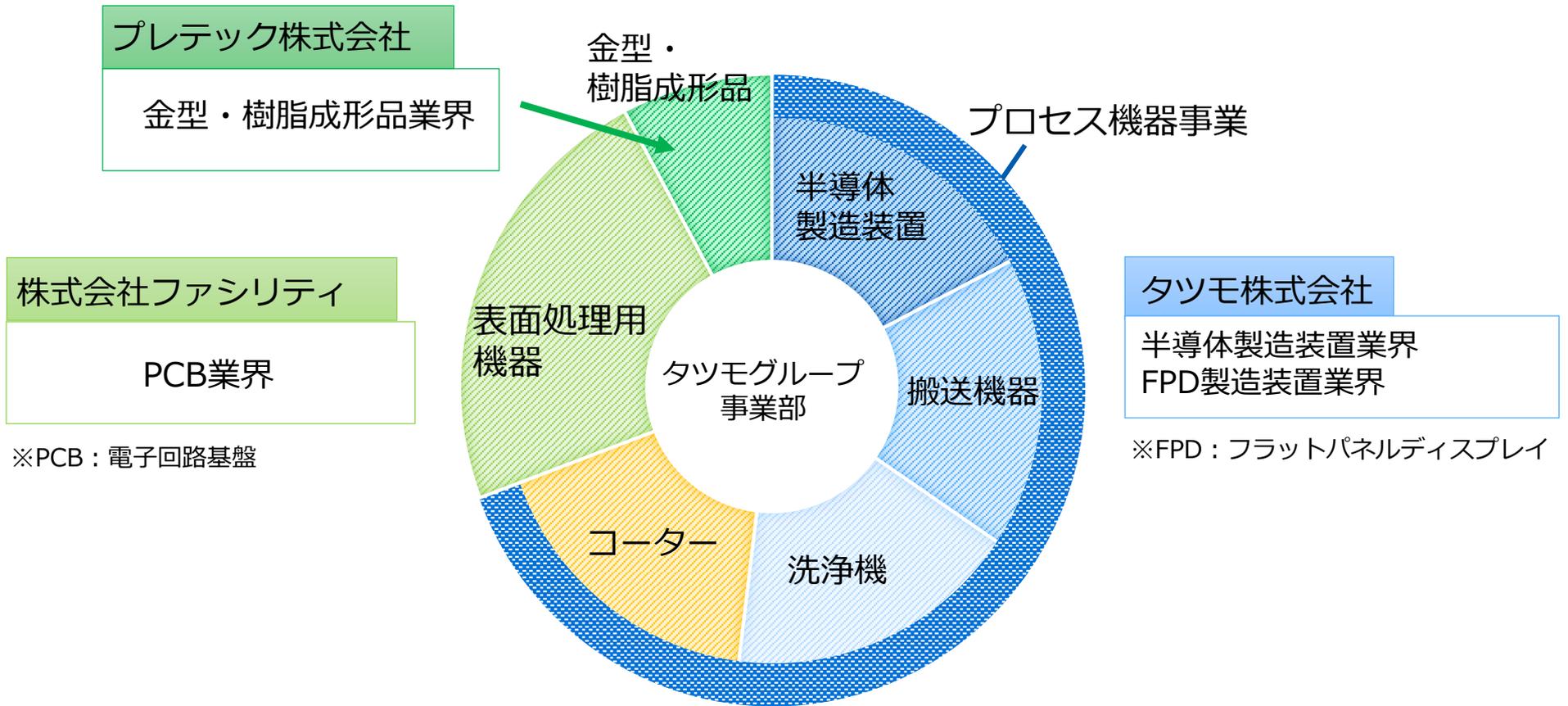
新株式発行により、資本金27億2,406万円へ増資

2019 本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転

2020 アプリシアテクノロジー株式会社を吸収合併







半導体製造装置、搬送ロボット、液晶製造装置、精密金型、樹脂成形品、めっき処理装置等の開発・製造・販売

半導体製造装置事業

半導体製造に用いられる薬液の塗布・現像装置や、シリコンウェーハ薄化のために支持体とウェーハを仮接合・剥離する装置等の開発・製造・販売



搬送機器事業

半導体製造装置に用いられるシリコンウェーハ等搬送ロボットやアライメント機器、またそれらをユーザー別の仕様にユニット化した製品等の開発・製造・販売



洗浄装置事業

半導体製造に用いられるシリコンウェーハ洗浄装置や、スラリーの供給装置、リン酸再生装置などの開発・製造・販売



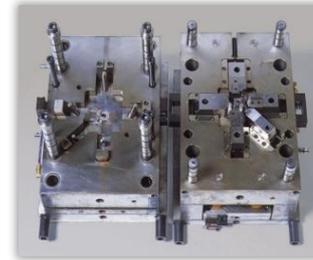
コーター事業

液晶カラーフィルター製造装置向けを中心としたガラス基板への薬液塗布装置の開発・製造・販売



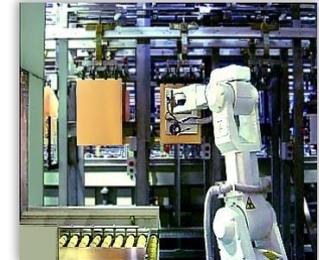
金型・樹脂成形品事業

電子機器部品用の金型の製作及び、その金型を使ったコネクタ等の樹脂成形品、エンボスキャリアテープの製造・販売



表面処理用機器事業

めっき処理装置や回路形成装置等のプリント基板製造装置等の開発・製造・販売



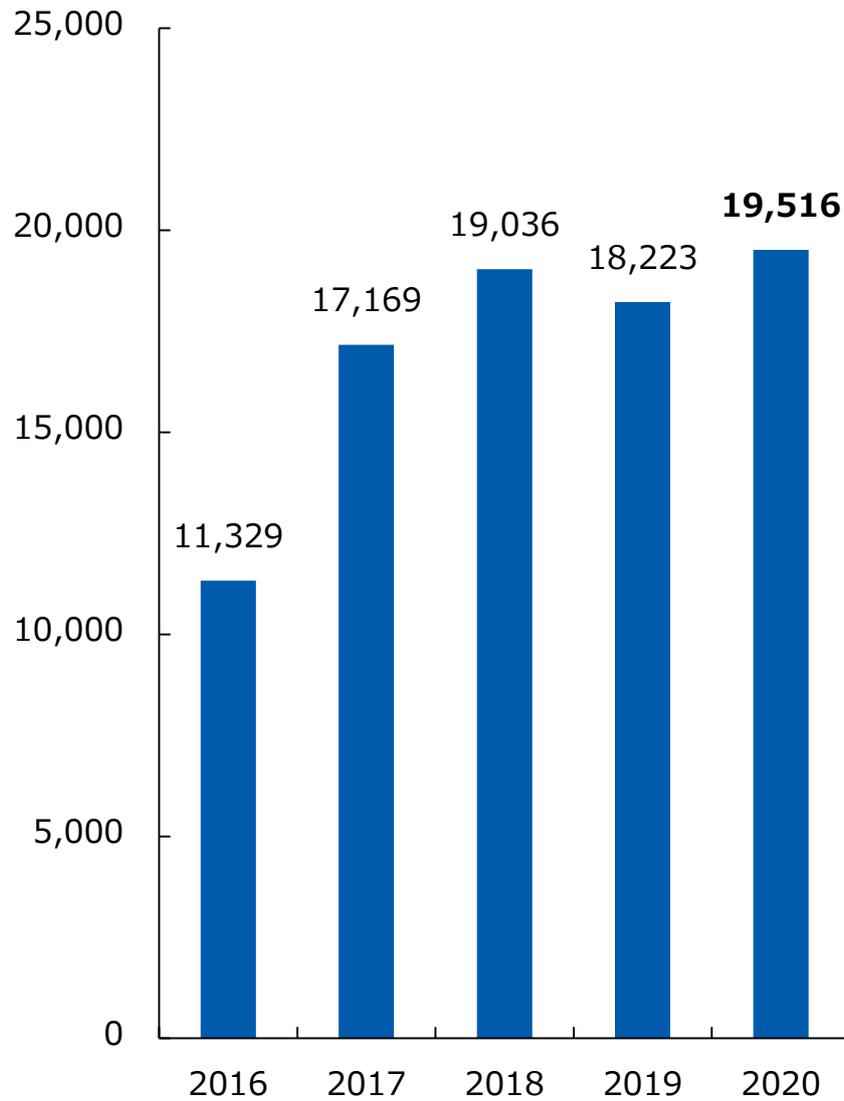
単位:百万円	'19年 12月期	'20年 12月期	売上比 (%)	修正後 今期計画	達成率 (%)
売上高	18,223	19,516	—	20,292	96.2
売上総利益	4,411	5,300	27.2	—	—
販管費	3,460	3,413	17.5	—	—
営業利益	951	1,886	9.7	1,844	102.3
経常利益	911	1,849	9.5	1,823	101.4
親会社株主に帰属する 四半期純利益	726	1,693	8.7	1,349	125.5

単位：百万円	'19年 12月期	売上比 (%)	'20年 12月期	売上比 (%)	修正後 今期計画	達成率 (%)
売上高	18,223	—	19,516	—	20,292	96.2
プロセス機器事業	12,600	69.1	14,675	75.2	15,394	95.3
半導体装置	2,553	14.0	4,046	20.7	4,736	85.4
搬送機器	5,729	31.4	5,320	27.3	4,656	114.3
洗浄機	1,905	10.5	2,760	14.1	3,131	88.2
コーター	2,411	13.2	2,547	13.1	2,871	88.7
金型・樹脂成形事業	1,437	7.9	1,352	6.9	1,404	96.3
表面処理用機器事業	4,185	23.0	3,489	17.9	3,494	99.9

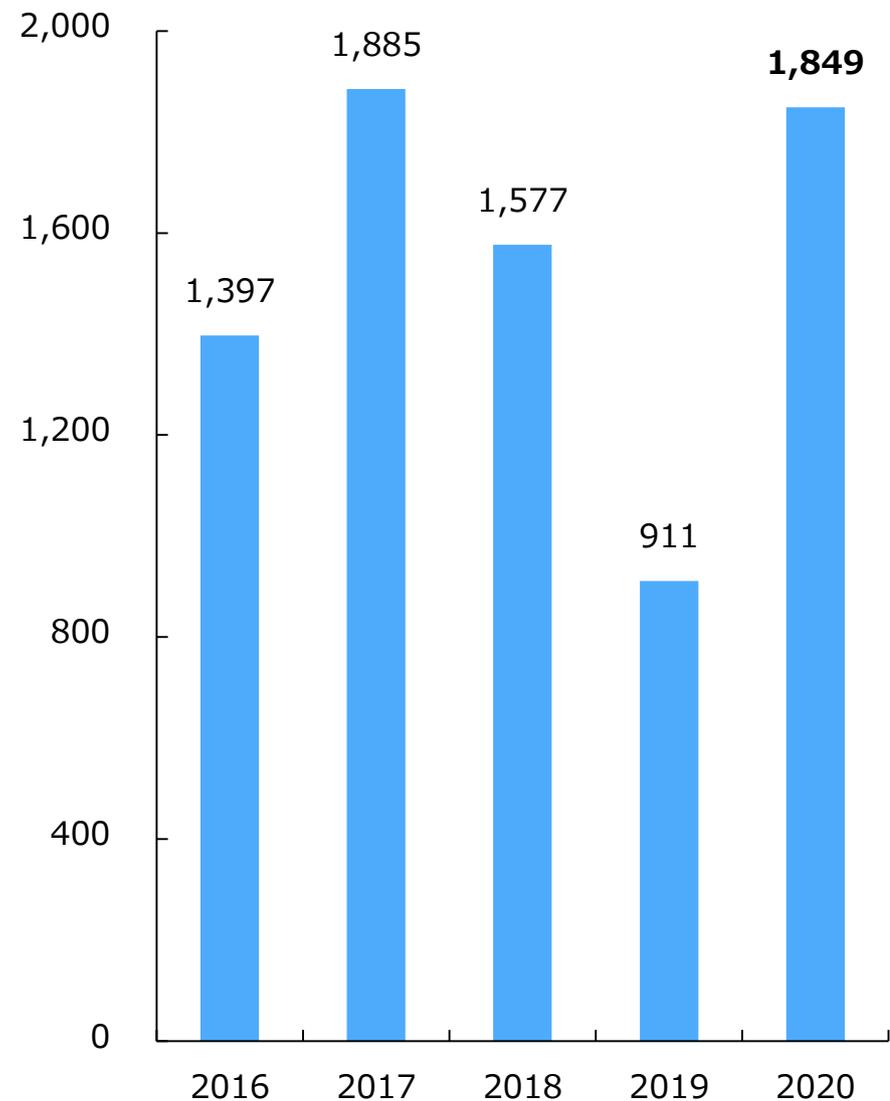
単位：百万円	'19年 12月期	売上比 (%)	'20年 12月期	売上比 (%)	修正後 今期計画	達成率 (%)
営業利益	951	5.2	1,886	9.7	1,844	102.3
プロセス機器事業	689	3.8	1,735	8.9	1,799	96.4
金型・樹脂成形事業	30	0.2	39	0.2	8	487.5
表面処理用機器事業	236	1.3	102	0.5	37	275.7
セグメント間連結消去	△5	—	8	—	—	—

単位：百万円

売上高推移

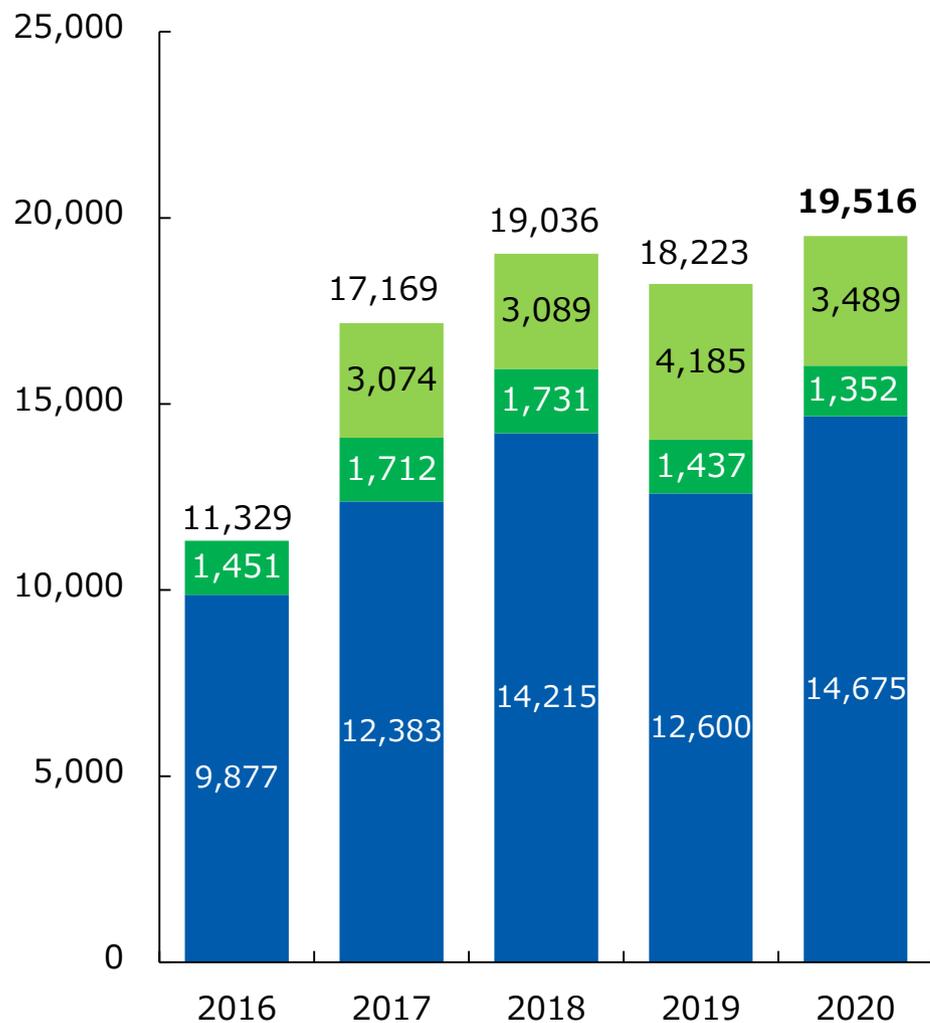


経常利益推移



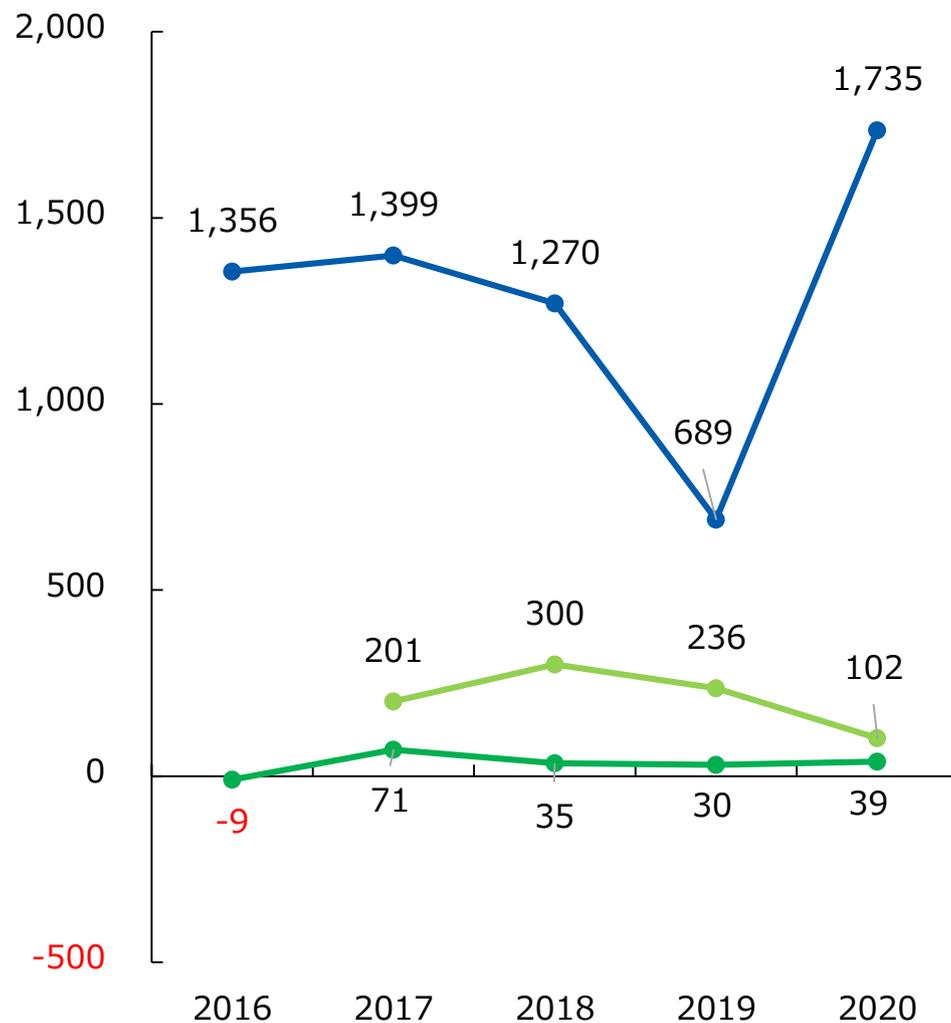
単位：百万円

売上高推移



■ プロセス機器事業 ■ 金型・樹脂成形事業
■ 表面処理用機器事業

営業利益推移



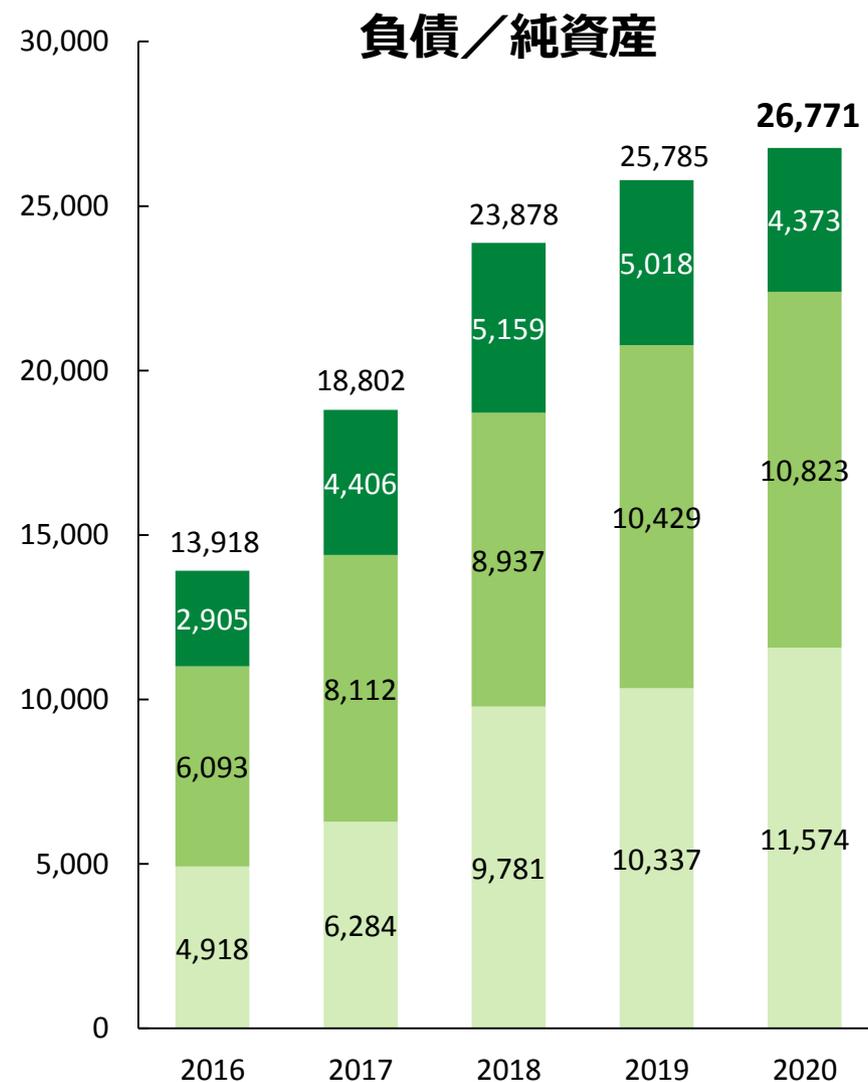
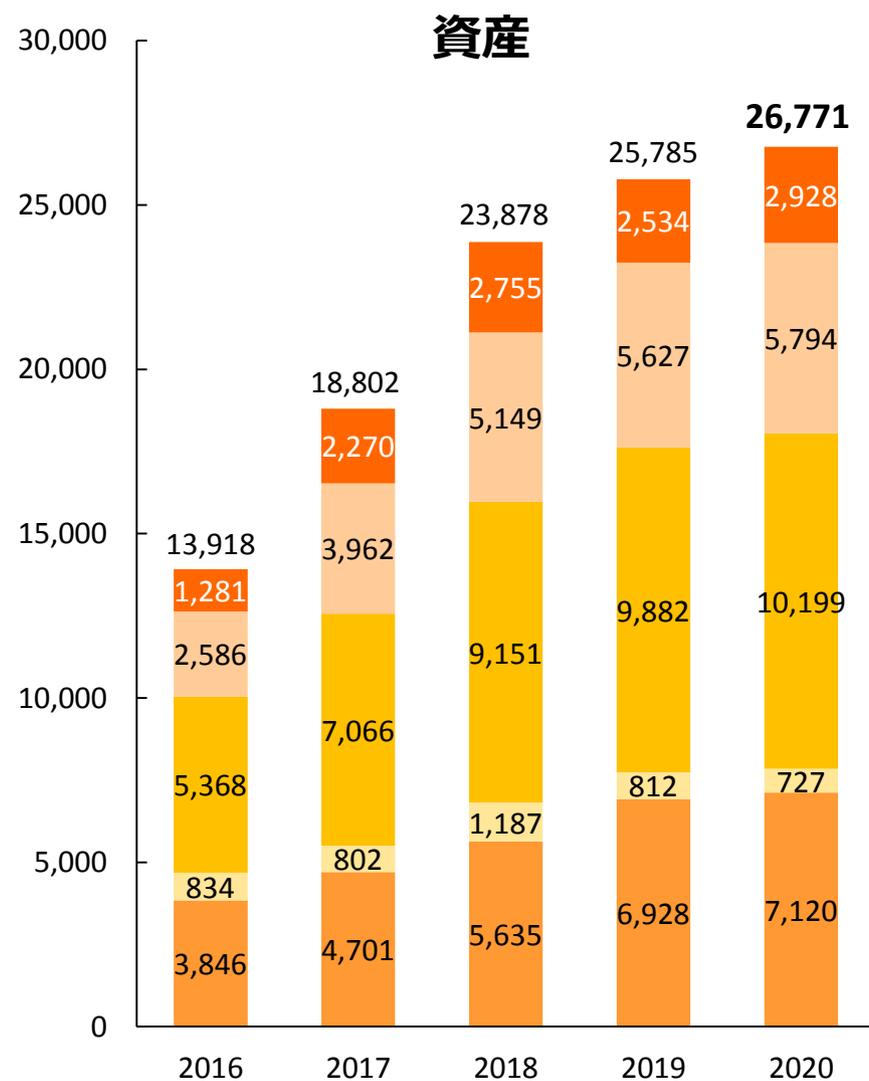
● プロセス機器事業 ● 金型・樹脂成形事業
● 表面処理機器事業

連結貸借対照表

単位：百万円	'19年12月期	'20年12月期	増減
流動資産	18,856	19,650	794
有形固定資産	5,950	5,788	△162
無形固定資産	162	171	9
投資その他資産	815	1,160	344
総資産	25,785	26,771	985
流動負債	11,814	12,154	340
固定負債	3,633	3,042	△591
純資産	10,337	11,574	1,236
自己資本比率	39.5%	42.6%	3.1P

主な増減		
資産		
	'20年12月期	前期末比
現金及び預金	2,928	394
受取手形及び売掛金	3,414	△578
電子記録債権	2,380	746
仕掛品	9,177	715
負債		
	'20年12月期	前期末比
支払手形及び買掛金	1,455	△216
電子記録債務	2,078	968
短期借入金	2,048	△128
前受金	4,710	△299
長期借入金	2,025	△516

単位：百万円



■ 固定資産 ■ その他流動資産 ■ たな卸し資産
■ 売掛債権 ■ 現金同等物

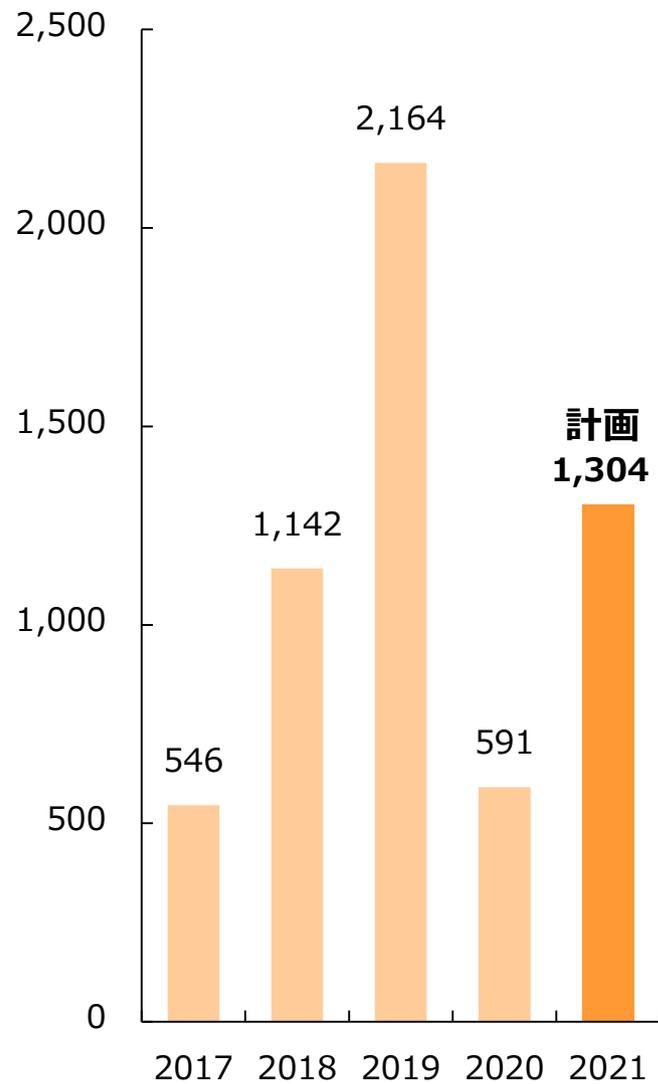
■ 純資産 ■ その他負債 ■ 有利子負債

適用	'19年12月期	'20年12月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,670	2,178
税金等調整前当期純利益	921	1,768
減価償却費	435	577
売上債権の増減額（△：増加）	△502	△234
たな卸資産の増減額（△：増加）	△759	△349
仕入債務の増減額（△：減少）	△771	805
前受金の増減額（△：減少）	2,072	△266

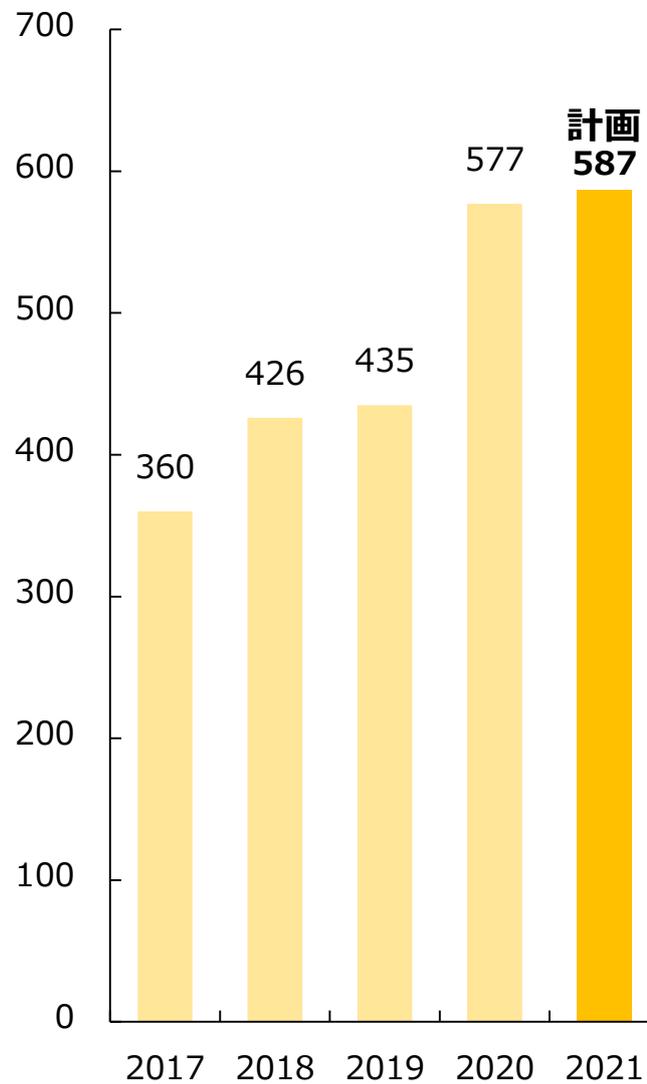
適用	'19年12月期	'20年12月期
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,547	△877
投資有価証券の取得による支出	△0	△200
有形固定資産の取得による支出	△1,492	△543
財務活動によるキャッシュ・フロー	△300	△1,059
長期借入による収入・短期借入金 の純増減	1,325	514
長期借入金の返済による支出	△1,465	△1,159
現金及び現金同等物に係る換算差額	△14	△26
現金及び現金同等物の増減額 (△：減少)	△191	214
現金及び現金同等物の期末残高	2,534	2,734

単位：百万円

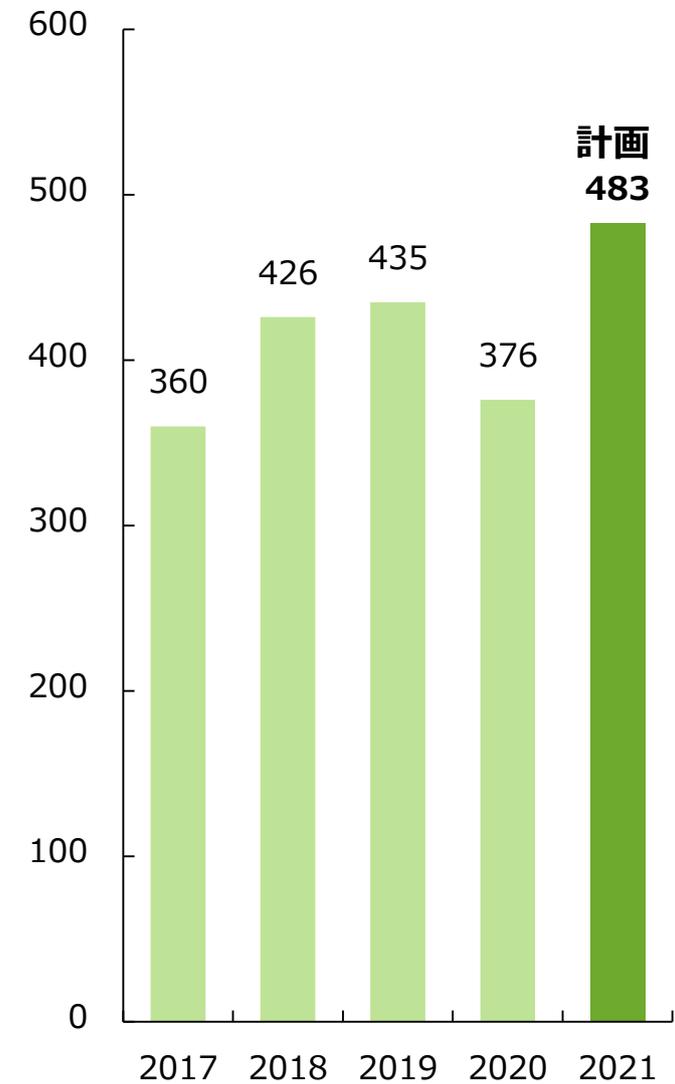
設備投資



減価償却費

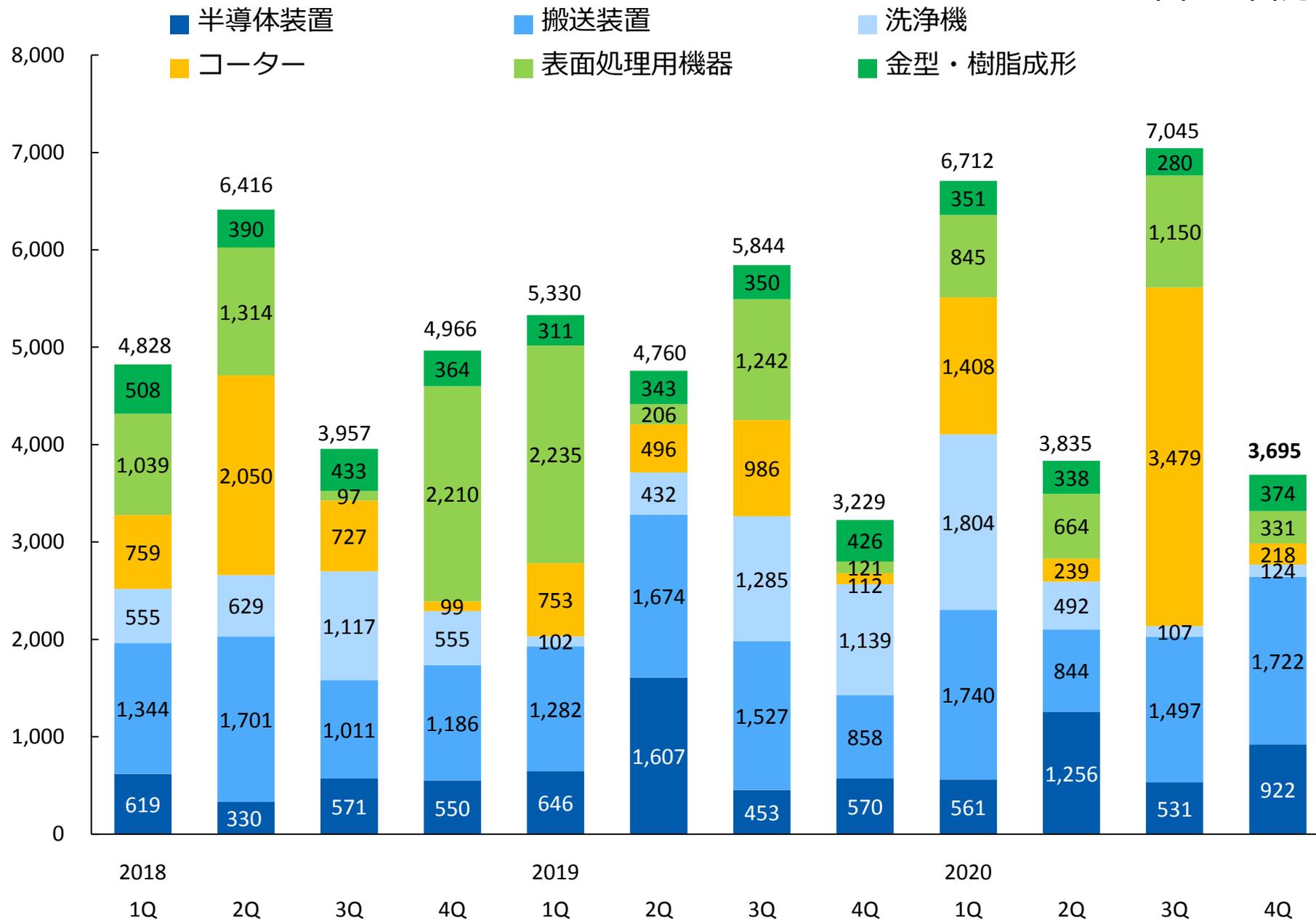


研究開発費



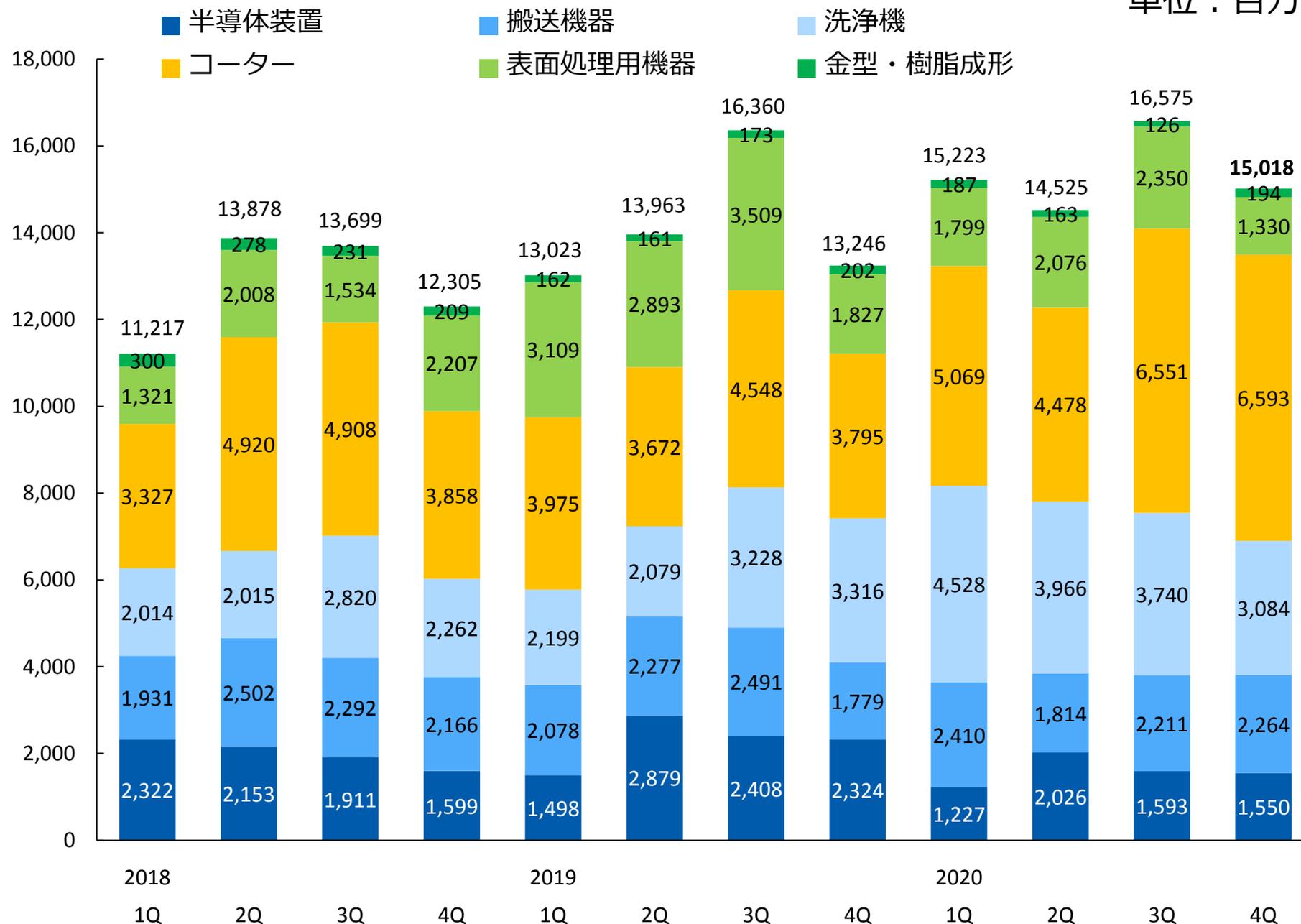
セグメント別 受注高推移

単位：百万円



セグメント別 受注残高推移

単位：百万円

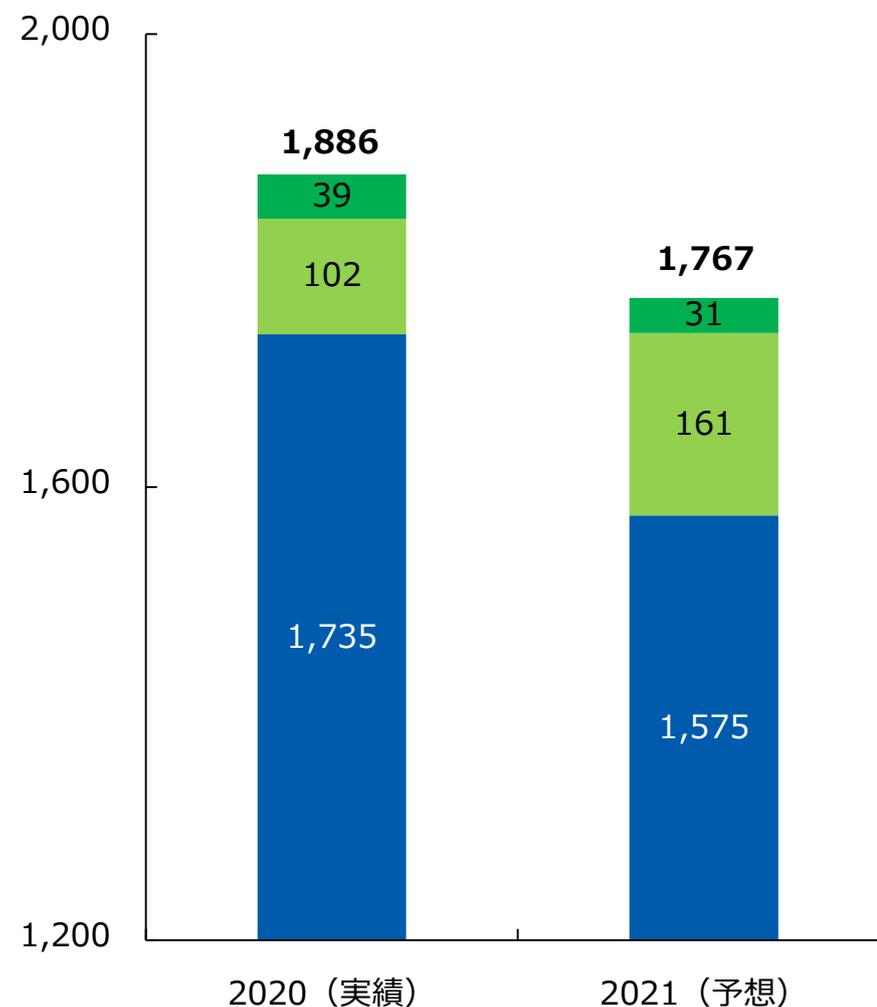
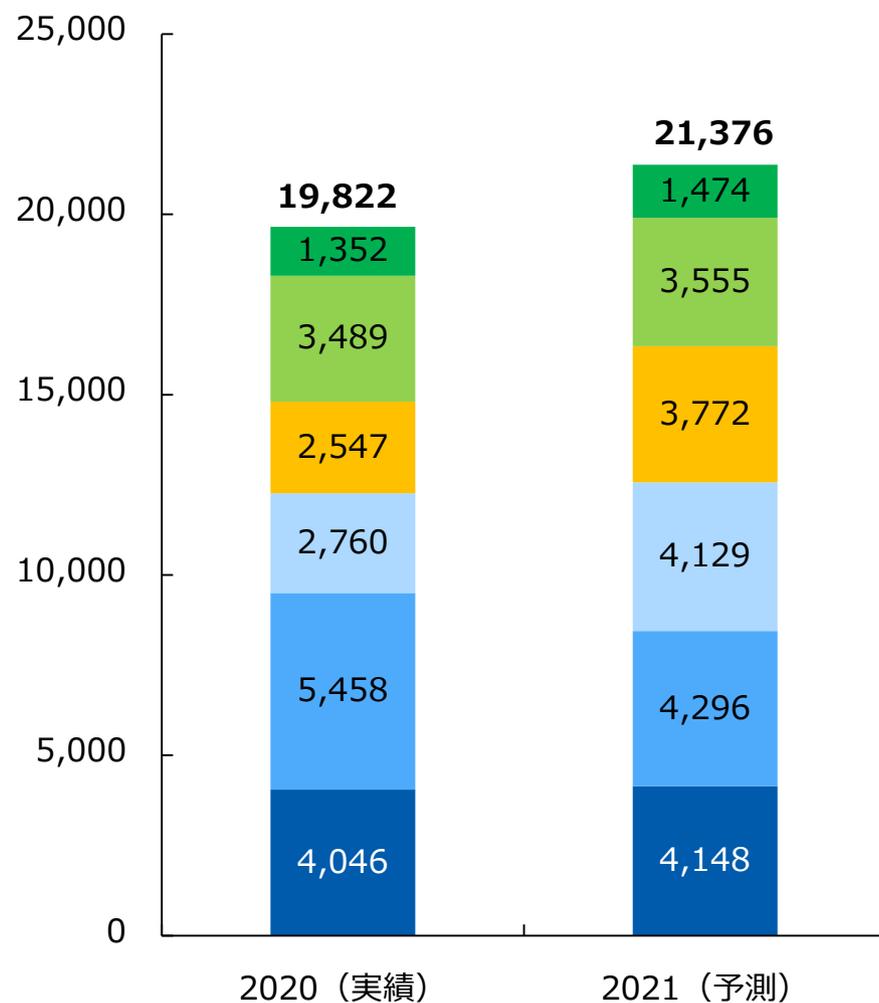


単位：百万円	第2四半期累計	通期	前期比 (通期増減)
売上高	8,369	21,376	1,554
プロセス機器事業	6,851	16,346	1,534
金型・樹脂成形品事業	714	1,474	△312
表面処理用機器事業	804	3,555	34
営業利益	408	1,767	△119
プロセス機器事業	514	1,575	△360
表面処理用機器事業	△104	161	59
金型・樹脂成形品事業	△1	31	△8
経常利益	385	1,724	△125
親会社株主に帰属する当期純利益	219	1,220	△473

単位：百万円

売上高

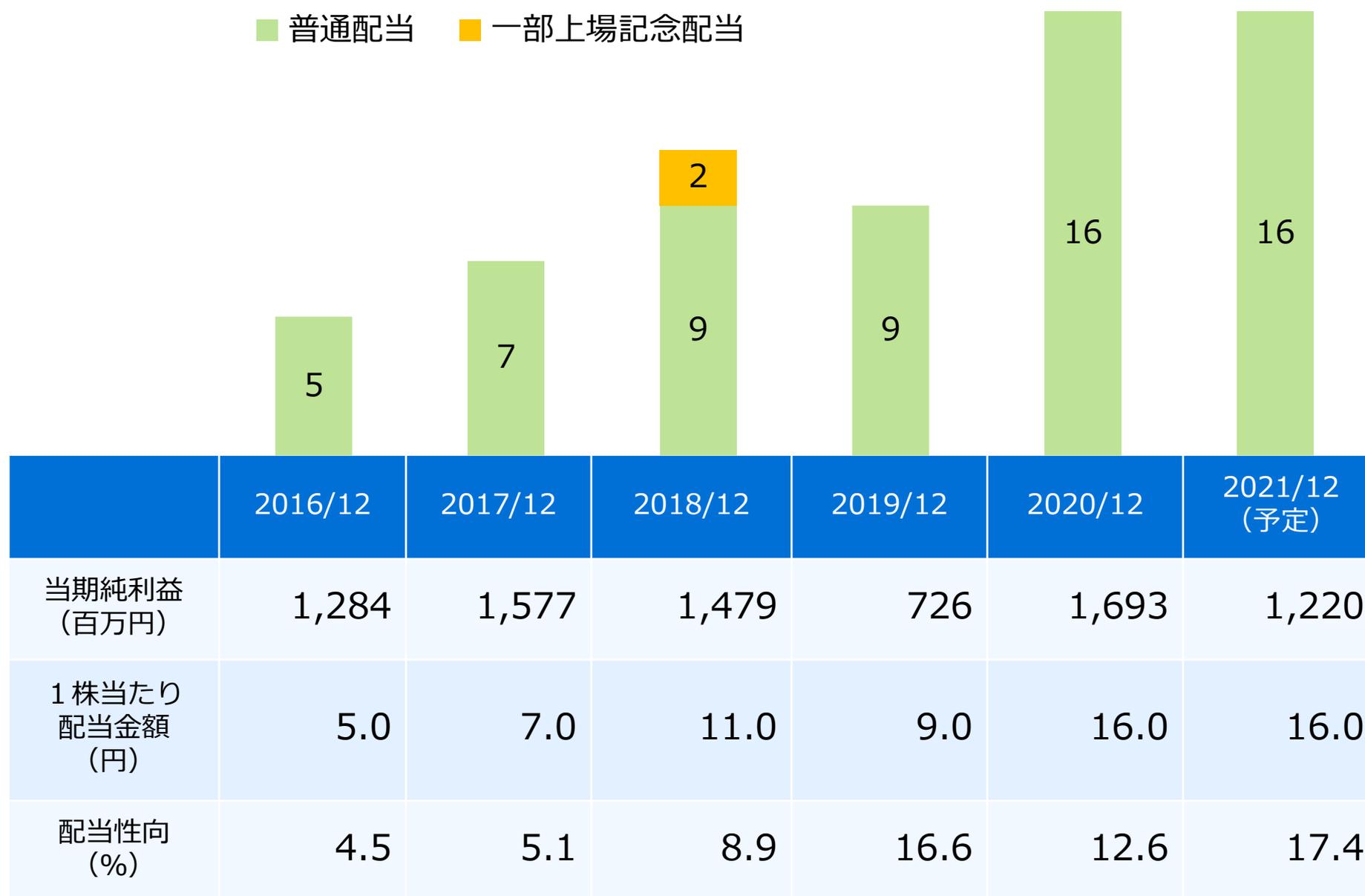
営業利益



- 半導体装置
- 搬送機器
- 洗浄機
- コーター
- 表面処理用機器
- 金型・樹脂成形

- プロセス機器
- 表面処理用機器
- 金型・樹脂成形

■ 普通配当 ■ 一部上場記念配当



※2017年1月1日付で1:3の株式分割を行っております。

本資料の取扱上の注意

本資料は、2021年2月12日発表の決算短信に基づいて作成されております。

また、本資料に記載されている業績予測等は、現在入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

掲載内容には最新の注意を払っておりますが、掲載されて無いように基づいて被った損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本資料に関するお問い合わせ先

タツモ株式会社 経営企画室

TEL 086-239-5000

FAX 086-239-5100

Email keiki@tazmo.co.jp



TAZMO